

性能特点

- 双组分室温或加热固化
- 100%固态，固化后无渗出物
- 应力低，更为有效地保护电器元件
- 卓越的耐高低温性，极好的耐候性，耐辐射及卓越的介电性能
- 卓越的化学和机械稳定性
- 触变性好，可自动化点胶施工

产品描述

PAKCOOL® TC-250 是双组分导热硅胶填缝剂，用作电子器件冷却的传热介质。在固化后与其接触表面紧密贴合以降低热阻从而更加有利于热源与其周围的散热片、主板、金属壳及外壳的热传导。本产品具有导热性能高、绝缘性能好以及便于使用等优点，可广泛用于个人便携式电脑的集成电路、微机处理器、内存模块、高速缓冲存储器、密封的集成芯片、DC/AC 转换器、IGBTs 及其它功率模块、半导体、继电器、整流器和变压器等的封装。

本产品由膏状的 A 和 B 组分组成。A 组分呈白色，B 组分为着色液体以便混合时鉴别 A 和 B 组分是否混匀。当 A 和 B 组分以 1:1 重量或体积比混和时，其可于室温下交联，加热可提高交联速度。

典型应用

- LED 组装
- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

- 本产品接触有些物质可能会不固化或不完全固化，这些物质包括：硫、磷、氮的化合物如聚砷、聚硫醚、聚氨酯、含酰胺、胺的物质，含锡、砷、锑、硒、碲成分的物质及一些不饱和的碳氢化合物及增塑剂等
- 因为 A/B 组分的粘度略有差异，如采用机器点胶，需对两组分的压力略做调整
- 请密封贮存，混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费

技术参数

特性	TC-250	测试方法
基材	双组分 RTV	--
颜色	A:白色 B:灰色	Visual
A/B 混合比例	1:1	--
粘度 (cP)	65 万 ± 25 万	ASTM D2196-15
操作时间(min @ 25°C)	≥30	--
导热系数 (W/m·K)	5.0	ASTM D5470
硬度 (Shore 00)	50 ± 10	ASTM D2240
密度 (g/cm ³)	3.30 ± 0.10	ASTM D792
介电强度 (kV/mm)	≥10	ASTM D149
体积电阻率 (Ω·cm)	≥3.0x10 ¹³	ASTM D257
阻燃	V-0	UL 94
保质期 (<0°C)	6 个月	--
连续使用温度 (°C)	-50~150	--

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

储存条件

- 本产品需低温储存，支装产品储存时需水平放置

包装规格

- 50mL/支，200mL/支，400mL/支或 25Kg/桶和 50Kg/桶的包装规格

固化时间

- 本产品在室温下放置 12 至 48 小时即可自然固化。其交联时间将随温度升高而缩短（参见下表）。

25°C	24 小时
70°C	60 分钟

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。